

公司代码：601231

转债代码：113045

公司简称：环旭电子

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	环旭电子	601231	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	刘立立
电话	021-58968418	021-58968418
办公地址	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,899,741,888.91	31,070,402,620.02	2.67
归属于上市公司股东的净资产	11,957,431,568.99	12,049,820,179.95	-0.77

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	22,273,274,806.52	17,017,029,927.61	30.89
归属于上市公司股东的净利润	551,039,407.60	505,584,056.07	8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,814,175.12	425,563,844.30	8.75
经营活动产生的现金流量净额	-602,692,214.93	143,667,689.35	-519.50
加权平均净资产收益率(%)	4.52	4.84	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)		62,197				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
环诚科技有限公司	境外法人	76.20	1,683,749,126	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	3.41	75,268,935	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.66	36,750,069	0	未知	
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	境外法人	1.17	25,939,972	25,939,972	质押	3,828,275
日月光半导体(上海)有限公司	境内非国有法人	0.82	18,098,476	0	无	0
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	其他	0.35	7,797,832	0	未知	
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	6,577,689	0	未知	
中联润世(北京)投资有限公司	境内非国有法	0.27	6,003,365	0	未知	

	人					
韩国银行—自有资金	其他	0.26	5,752,405	0	未知	
挪威中央银行—自有资金	其他	0.21	4,733,700	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

2021年3月，公司公开发行可转换公司债券，募集资金用于盛夏厂芯片模组生产项目、惠州厂电子产品生产项目、越南厂可穿戴设备生产项目和补充流动资金项目。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。